

Bild: AdobeStock_Sergij

Online-Forum **Dosiertechnik**

Elektronische Komponenten prozesssicher abdichten, vergießen und kleben

– Trends. Dosiertechnik. Praxis. **28.09.2021** – die Themen im Überblick

Uhrzeit	Vortragstitel	Referent:in
09.00 - 09.15	Check-in	
09.15 - 09.25	Begrüßung und Technik-Tipps	Sandra Kiefer
09.25 - 09.35	Talk mit Marco Rodriguez, as adhesive solutions e.K.	
09.35 - 10.05	Agiles entwickeln in Automotive, was bedeutet das für Dosierprojekte? Lösungskompetenz bei der Entwicklung interdisziplinärer Technologie-Konzepte	Olaf Letzner DoBoTech AG
10.05 - 10.35	Miniaturisierung: Prozesssicher dosieren – auch bei immer kleineren Dosierstellen und kürzeren Taktzeiten – Der Weg zur Lösung der Dosieraufgabe	Benjamin Zeno Kratz perfectdos GmbH
10.35 - 11.05	Dosiertechnik in der 3D-additiven Fertigung – Ein neuartiges Verfahren stellt aus einem Guss funktionale Baugruppen für die Elektronik her	Bruno Affolter Infotech AG
11.05 - 11.35	Break-Out-Sessions 1: Agile Entwicklungsprojekte 2: Miniaturisierung 3: Additive Fertigung	Netzwerken im kleinen Kreis mit Olaf Letzner Benjamin Zeno Kratz Bruno Affolter
11.35 - 12.15	Mittagspause	
12.15 - 12.25	Talk mit Marco Rodriguez, as adhesive solutions e.K.	
12.25 - 12.55	Solide Verklebungen im Minutentakt Kurze Taktzeiten bei Klebprozessen und was dafür benötigt wird	Philipp Hug nolax AG
12.55 - 13.25	Prozessplanung aus der Sicht des Klebstoffherstellers Die optimale Vorgehensweise zur Planung des Fertigungsprozesses	Ralf Partenheimer Three Bond GmbH
13.25 - 13.55	Niederdruckplasma – für eine bessere Adhäsion Plasmaprozesse, Anwendungsgebiete von Plasma, Testverfahren	Achim Rentschler plasma technology GmbH
13.55 - 14.25	Break-Out-Sessions 1: Taktzeiten 2: Prozessplanung 3: Niederdruckplasma	Netzwerken im kleinen Kreis mit Philipp Hug Ralf Partenheimer Achim Rentschler
14.25 - 14.40	Kurze Entspannungspause	
14.40 - 15.10	Plasmavorbereitung - Prozesssicherheit effektiv maximieren Volle Prozesssicherheit bei der Plasmabehandlung sicherstellen	Peter van Steenacker Tigres GmbH
15.10 - 15.40	Vorbereitung von Metalloberflächen vor dem Kleben In der Automobilproduktion Verschmutzungen bei optimierter Korrosionsstabilisierung entfernen	Edwin Büchter Clean-Lasersysteme GmbH
15.40 - 16.10	Luft klebt und dichtet nicht! Materialien optimal für ein prozesssicheres Dosieren mischen	Mathias Grundschtötel Hauschild GmbH & Co KG
16.10 - 16.40	Break-Out-Sessions 1: Plasmavorbereitung 2: Laservorbereitung 3: Prozesssicher Mischen	Netzwerken im kleinen Kreis mit Peter van Steenacker Edwin Büchter Mathias Grundschtötel

Wir danken unserem teilnehmenden Marketingpartner

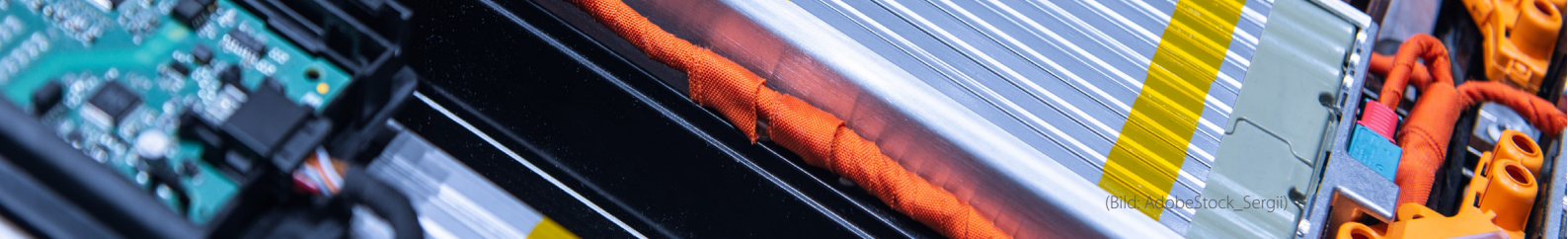


Zur Anmeldung:

www.isgatec.com > Forum

Ihre Fragen beantwortet Sandra Kiefer: +49 (0) 621-717 68 88-4

ISGATEC®
FORUM



(Bild: AdobeStock_Sergii)

Online-Forum **Dosiertechnik** **Elektronische Komponenten prozesssicher abdichten, vergießen und kleben** – Trends. Dosiertechnik. Praxis. **29.09.2021** – die Themen im Überblick

Uhrzeit	Vortragstitel	Referent:in
09.00 - 09.15	Check-in	
09.15 - 09.25	Begrüßung und Technik-Tipps	Sandra Kiefer
09.25 - 09.35	Talk mit Marco Rodriguez, as adhesive solutions e.K.	
09.35 - 10.05	Systemberatung für Komplettlösungen in der Dosiertechnik Alles aus einer Hand – welche Möglichkeiten bietet die Unterstützung durch ein Handelshaus	Clemens Boll AAT Aston GmbH
10.05 - 10.35	Automatisierungskonzepte: flexibel und prozesssicher – Auch bei kürzer werdenden Produktzyklen flexible und prozesssichere Produktionskonzepte realisieren	Sascha Bender RAMPF Production Systems GmbH & Co. KG
10.35 - 11.05	Die Mikrodosierung und ihre Herausforderung Der sinnvolle Einsatz von Mikrodosiertechnik in Kombination mit Robotik	Christoph Knöpfle Musashi Engineering Europe GmbH
11.05 - 11.35	Yes we can: Anlagen kostensparend erneuern Retrofit bringt Schäumungs-, Verguss- & Klebeanlagen auf dem aktuellsten Stand der Technik	Martin Scharf scharf automation gmbh
11.35 - 12.05	Break-Out-Sessions 1: Systemberatung 2: Automatisierung 3: Mikrodosieren und Robotik 4: Retrofit	Netzwerken im kleinen Kreis mit Clemens Boll Sascha Bender Christoph Knöpfle Martin Scharf
12.05 - 12.45	Mittagspause	
12.45 - 12.55	Talk mit Marco Rodriguez, as adhesive solutions e.K.	
12.55 - 13.25	Scheinwerfer sicher abdichten, kleben, vergießen Prozesssichere Materialentnahme, Aufbereitung und hochpräzise Dosierung	Korbinian Widderich ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik GmbH
13.25 - 13.55	UV-CIP Dichtungen für wieder öffnbare LE-Gehäuse Ganzheitliche Betrachtung – vom Dichtstoff über Prozess bis zum fertigen Funktionsteil	Thomas Brandl DREI BOND GmbH
13.55 - 14.25	Sensible Elektronik gut geschützt gegen schädliche Außeneinflüsse Kleben, Vergießen und Abdichten von Sensoren	Birgit Maily-Baumann Scheugenpflug GmbH
14.25 - 14.55	Break-Out-Sessions 1: Scheinwerfer 2: Gehäuseabdichtung 3: Sensoren	Netzwerken im kleinen Kreis mit Korbinian Widderich Thomas Brandl Birgit Maily-Baumann
14.55 - 15.10	Kurze Entspannungspause	
15.10 - 15.40	E-Mobility: Prozesssichere Dosier-Applikationen und verwandte Prozesse Präzisions-Applikationen von flüssigen bis pastösen, 1K- und 2K- Materialien	Volker Jagielki Nordson Deutschland GmbH
15.40 - 16.10	Imprägnier- und Pulverbeschichtung für die Serienfertigung von Elektromotoren Optimale Prozesslösungen aus einer Hand	Andy Jorissen bdtronic GmbH
16.10 - 16.40	Verguss von EV/HEV-Motoren mit Hochleistungs-Harzsystemen Re-Design von Statoren, die ursprünglich nicht für die Vergusstechnologie entwickelt wurden	Manuel Hüning DEMAK Group
16.40 - 17.10	Break-Out-Sessions 1: Thermomanagement 2: E-Motoren 3: E-Motoren Re-Design	Netzwerken im kleinen Kreis mit Volker Jagielki Andy Jorissen Manuel Hüning

Wir danken unserem teilnehmenden Marketingpartner



Zur Anmeldung:

www.isgatec.com > Forum

Ihre Fragen beantwortet Sandra Kiefer: +49 (0) 621-717 68 88-4

ISGATEC®
FORUM